

技術資料

EP-2009-6-H-117

B-Stage 絕緣接著膠

簡介:

EP-2009-6-H-117 適用於鋼板/網印製程。主要用於壓合/封蓋等製作，可用於黏著玻璃/金屬/陶瓷等。
屬兩段式烘烤產品。

特徵:

- 適用於鋼板印刷
- 不易吸濕
- 基板不易翹曲

硬化前特性		測試條件	測試方法
比重	1.25 g/cc	比重計	FT-P001
外觀	黑色		
黏度 @ 25°C	30000 – 35000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	3.4 – 3.8	Brookfield DV-III/CP-51 Visc @ 0.5rpm/Visc @ 5rpm	FT-P008
細度	<20µm	細度計	FT-P025
使用壽命 @ 25°C	48 小時	黏度升高 25%@ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -15 到 -40 °C	6 月		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
B-stage 硬化條件		40 - 60 分鐘 @ 85 °C; 使用者可依製程需求調整溫度與時間，控制 B-Stage 膠的軟硬程度，及壓合時所需的壓力大小，以得到後續 C-CURE 後，最佳的黏著力	
C-stage 硬化條件		90 - 120 分鐘 @ 175 °C; 溫度越高，時間越長 Tg 越高	
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	12 Kg/die	晶片尺寸 2x2mm, 玻璃基板	FT-M012
晶片推力 @260°C	3 Kg/die	晶片尺寸 2x2mm, 玻璃基板	FT-M012

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

***EP-2009-6-H-117* B-Stage 絕緣接著膠**

物理化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度(Tg)	105 °C	DMA 3 點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數		TMA 膨脹模式	FT-M016
< Tg	50 ppm/°C		
> Tg	170 ppm/°C		
儲存模數		DMA 3 點彎曲模式	FT-M019
@ -60°C	2100 MPa	試片厚度 <1.5 mm	
@25°C	1800 MPa		
@150°C	25 MPa		
@250°C	10 MPa		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。